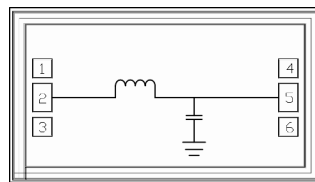


## 性能特点

- 通带频率：DC–9 GHz
- 通带插损：1.3 dB
- 回波损耗：25 dB
- 阻带衰减：20 dB @12.7GHz；40 dB @14.7GHz
- 芯片尺寸：1.5X0.8X0.15 mm

## 功能框图



## 产品介绍

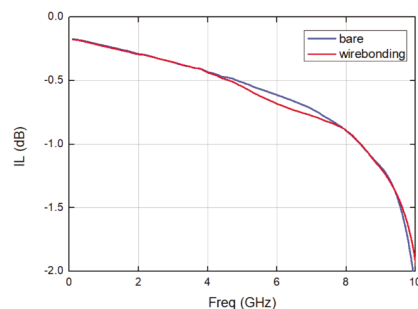
ZXA8009是一款低通滤波器芯片，通带频率为DC–9GHz，通带插损1.3dB，阻带衰减为20dB @12.7GHz、40dB @14.7GHz。该滤波器芯片采用了片上金属化通孔工艺，无需额外的接地措施；芯片背面进行了金属化处理，适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

## 电气性能参数 (TA = +25℃)

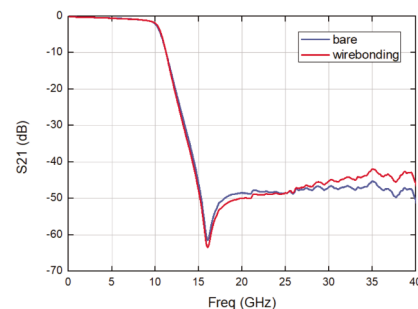
| 参数   | 最小值        | 典型值 | 最大值 | 单位  |
|------|------------|-----|-----|-----|
| 通带频率 | DC         |     | 9   | GHz |
| 通带插损 |            | 1.3 | 1.6 | dB  |
| 阻带衰减 | 20@12.7GHz |     |     | dB  |
|      | 40@14.7GHz |     |     | dB  |
| 回波损耗 |            | 25  |     | dB  |

## 典型测试曲线

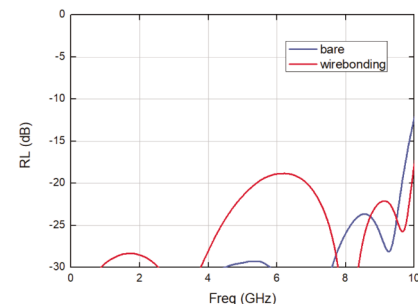
通带损耗 VS 频率



带外抑制 VS 频率



回波损耗 VS 频率



## 使用限制参数

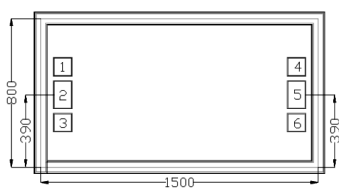
| 项目     | 数值           |
|--------|--------------|
| 最高输入功率 | +25 dBm      |
| 工作温度   | -55 ~ +125 ℃ |
| 储存温度   | -65 ~ +150 ℃ |



该产品对静电较敏感  
使用中请注意防静电

\*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏

## 键合点定义



说明

- 单位：μm
- 芯片背面镀金接地
- 键合压点尺寸：150X100μm

| 管脚                     | 名称     | 描述                |
|------------------------|--------|-------------------|
| 2                      | RF IN  | 射频信号输入端，芯片内部无隔直电容 |
| 5                      | RF OUT | 射频信号输出端，芯片内部无隔直电容 |
| 1/3/4/6                | GND    | 地焊盘,片内接地          |
| 芯片输入与输出结构对称，2、5端口可互换使用 |        |                   |

## 装配说明：

- 芯片厚度100um。
- 在净化环境装配使用，不要碰触表面，以免损伤芯片。
- 输入输出使用2根金丝键合（直径25um），键合线尽量短，不要长于400um。
- 用Au80Sn20 金锡烧结，温度不要超过300℃，烧结时间不要超过 30 秒。
- 本品属于静电敏感器件，储存和使用时注意防静电。
- 干燥、氮气环境下保存。

## 装配示意图

